

Seeding Layer를 이용한 PZT Thin Film의  
결정립 미세화  
The Grain Size Minimization of PZT Thin Film  
using the Seeding Layers

김태호, 김지영  
국민대학교 금속재료공학과

### 1. 서론

오늘날 차세대 비휘발성 반도체 메모리로서 강유전체 관하여 활발히 연구가 진행되고 있다. 또한 고집적화를 위해 1T-1C구조의 메모리 셀 구조가 연구되고 있으며 강유전체 캐퍼시터의 대표적인 물질로는 BST ((Ba,Sr)TiO<sub>3</sub>), SBT (SrBi<sub>2</sub>Ta<sub>2</sub>O<sub>9</sub>) PZT (Pb(Zr,Ti)O<sub>3</sub>)등이 널리 알려져 있다. 본 연구에서는 가장 주목받고 있는 PZT에 관하여 연구를 하였다. PZT의 Grain Size가 조대할 경우 Device의 불균일성을 초래하기 때문에 미세한 Grain이 요구되어진다. 그리고 Pb에 의한 강한 휘발성 때문에 Pyrochlore Phase가 형성되어 불균일한 전기적인 성질을 갖기 때문에 이를 개선하기 위해 Seeding Layer로 PT(PTiO<sub>3</sub>)를 증착시켜 PZT 박막의 morphology 및 결정화 그리고 전기적인 특성에 관해서 PTiO<sub>3</sub>가 PZT에 미치는 영향과 Grain Size의 변화에 대해서 조사하였다.

### 2. 실험방법 및 결과

Seeding Layer를 갖는 Pt/TiO<sub>2</sub>/SiO<sub>2</sub> Substrate 위에 PZT를 Sol-gel법을 이용하여 증착하였다. Seeding Layer로 사용된 PT와 TiO<sub>2</sub>는 각각, Sol-gel법과 D.C Sputtering으로 증착을 하였다. PZT Film은 600°C, 산소분위기에서 30분간 열처리를 하였다. 상부전극은 Shadow Mask를 이용하여 Pt를 1000Å 증착하였고 그 크기는  $2 \times 10^{-4} \text{cm}^2$  이다.

PZT 박막의 Microstructure는 SEM, XRD등을 이용하여 분석하였고, PZT Film 두께의 변화에 따라서 Hysteresis Loop, Leakage Current 등을 Pr, Switching, Non-Switching 값 등으로 비교 조사하였다. Seeding Layer를 사용한 Device에서는 아주 미세한 Grain이 관찰되었다. PZT Thin Film의 Microstructure는 Crystallization 온도가 낮은 Seeding Layer를 이용함으로서 제어할 수 있고, Grain Size를 제어함으로서 유전물질의 특성도 변화시킬수 있다.